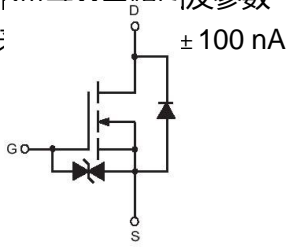




版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
F		2017-4			
G	1.2	2018-12	按客户要求，修改等效电路图及参数 $I_{GSS}$ 由原来 $\pm 100 \text{ nA}$ 改为 $\pm 10 \text{ uA}$	蓝月葵	刘晓荣
H	1.2	2021-5-28	修改为不带等效由路图及参数 $I_{GSS}$ 由原:  $\pm 100 \text{ nA}$	黄超	庞隆基
I	2021-8-31	1	特征栏增加无卤标示做无卤规格书	陆丽英	刘晓荣
J	2021-11-15	2	增加 $C_{iss}$ 、 $C_{oss}$ 、 $C_{rss}$ 参数	黄超	庞隆基
A	2022-4-23	all	型号加 BR/Q，特征及应用增加汽车产品描述（符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求、满足汽车应用的严格要求），印章 H 改为 Q，峰值温度 $245 \pm 5$ ，时间持续为 $5 \pm 0.5 \text{ sec}$ 更新为：峰值温度 $255 \pm 5$ ，时间持续为 $5 \pm 0.5 \text{ sec}$ 。	黄超	庞隆基

SOT-23 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

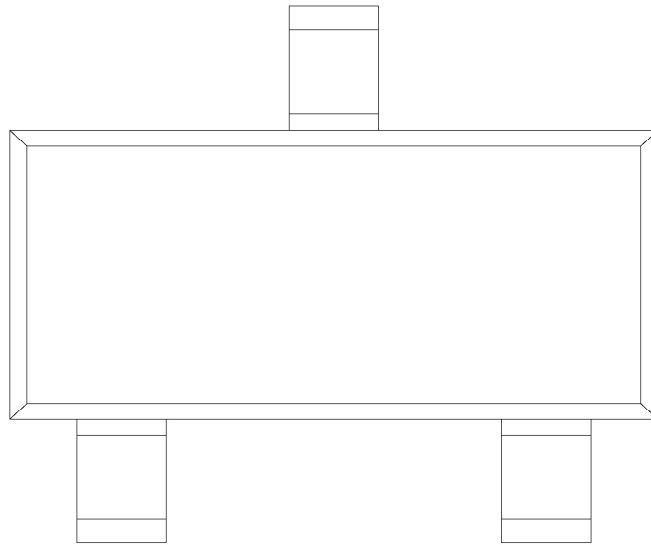
输出电阻小、性能高；SOT-23 封装，利于设计安装，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。  
Low  $R_{DS(on)}$ , rugged and reliable, compact industry standard SOT-23 surface mount pac~



参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	$V_{DSS}$	50	V
	$V_{GSS}$	±20	V
Continuous	$I_D$	220	mA
Peak Drain Current	$I_{DM}$	880	mA
Power Dissipation	$P_D$	360	mW
Thermal Resistance, Junction-to-			

Rev.A Apr.-2022

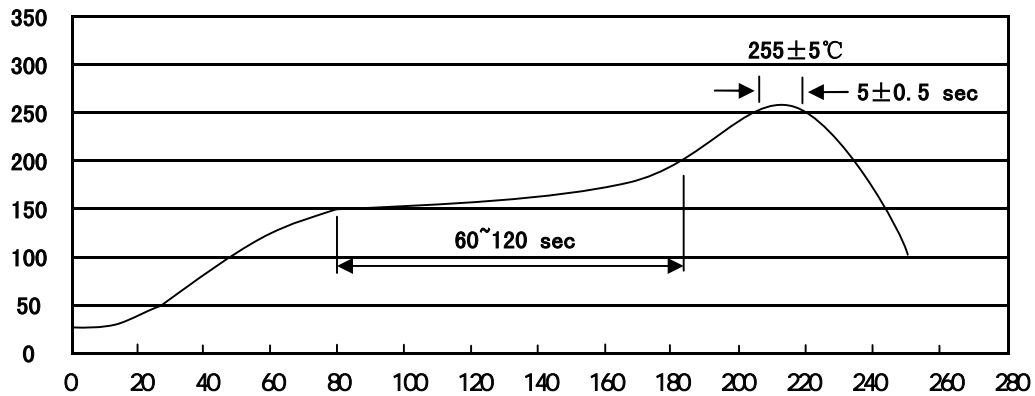
Rev.A Apr.-2022





Rev.A Apr.-2022

### Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 150~200°C，时间 60~120sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

卷盘包装 / REEL

Package Type	Units					Dimension (unit mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205